

UF 120HA 底部填充胶 产品数据表

卓越的耐热循环性能
100% 兼容免清洗助焊剂残留
可承受 5 次 260 °C 回流焊

简介

UF 120HA 是一种高填料、高纯度的液态环氧底部填充胶，能够流入极窄的芯片间隙。该产品与所有免清洗焊膏助焊剂残留完全兼容，在 5 次 260 °C 回流焊条件下不会产生任何焊点变形，其性能优于需要清洗工艺的所有同类底部填充材料。UF 120HA 适用于 BGA、倒装芯片、晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP) 以及裸芯片保护，广泛应用于存储卡、芯片载体、混合电路、多芯片模块等多种先进封装形式。

使用 UF 120HA 的主要优势包括

- ❖ 与所有免清洗焊膏助焊剂残留完全兼容
- ❖ 免除清洗工艺及其带来的环境污染
- ❖ 显著降低制造成本
- ❖ 可通过 5 × 260 °C 回流焊
- ❖ 焊点无任何变形
- ❖ 性能优于采用清洗工艺的所有竞品底部填充胶
- ❖ 可流入 20 μm 的微小间隙
- ❖ 低温快速固化(<120 °C)

物理特性

产品名称	UF 120HA 液态封装胶
外观	黑色
未固化材料性能	
项目	数值
比重(ASTM D 1475-60)	1.6 g/cc

粘度 (Spindle#4/20rpm)	15-25kcp
已固化材料性能	
Tg ASTM D3418-82	160 °C
C.T. E (ASTM E 831), PPM /°C	$\alpha_1 = 20; \alpha_2 = 78$
剪切强度 (FR4 / FR4)	3500 psi
提取离子(MIL-STD-883E)	
Na+	<5ppm
K+	<5ppm
F-	<5ppm
Cl-	<10ppm
表面绝缘电阻 (J-STD-004)	通过 (Pass)

推荐固化工艺

在 120 °C 条件下固化 15 分钟(不包含升温时间)。根据客户需求, 可提供并评估其他替代固化曲线。

储存与保质期

在 -40 °C 条件下, 若材料存放于密封的原始包装容器中, 保质期为 6 个月。超过该期限存放, 产品粘度可能会升高。储存时应避免 水分侵入、挥发及异物污染。挥发和污染可能会对产品的加工性能产生不利影响。

安全须知

UF 120HA 为一种环保、无毒材料。但在操作和使用过程中, 仍建议遵循一般工业卫生规范。有关更详细的安全信息, 请参阅本产品的 SSDS (材料安全数据表)。

包装规格

UF 120HA 毛細管底部填充系列產品有售 10 cc 和 30 cc 两种标准包装规格。根据客户需求，亦可提供其他包装形式。如需订购或获取更多信息，请联系 YINCAE。